

公司代码：688206

公司简称：概伦电子



上海概伦电子股份有限公司  
2025年年度报告摘要

## 第一节 重要提示

1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 网站仔细阅读年度报告全文。

### 2、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“四、风险因素”的相关内容。

3、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、 公司全体董事出席董事会会议。

5、 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

### 7、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2025 年度，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份数为基数分配利润，利润分配方案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本 435,177,853 股，扣除回购专用账户 1,300,070 股，可参与利润分配股数 433,877,783 股，以此合计拟派发现金红利 13,016,333.49 元（含税）。2025 年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本。

本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

母公司存在未弥补亏损

适用 不适用

8、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

## 第二节 公司基本情况

### 1、公司简介

#### 1.1 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	概伦电子	688206	不适用

#### 1.2 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

#### 1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑芳宏	/
联系地址	上海市浦东新区银冬路20弄集鼎天地3号楼17层	/
电话	021-61640095	/
传真	021-61640095	/
电子信箱	IR@primarius-tech.com	/

## 2、报告期公司主要业务简介

### 2.1 主要业务、主要产品或服务情况

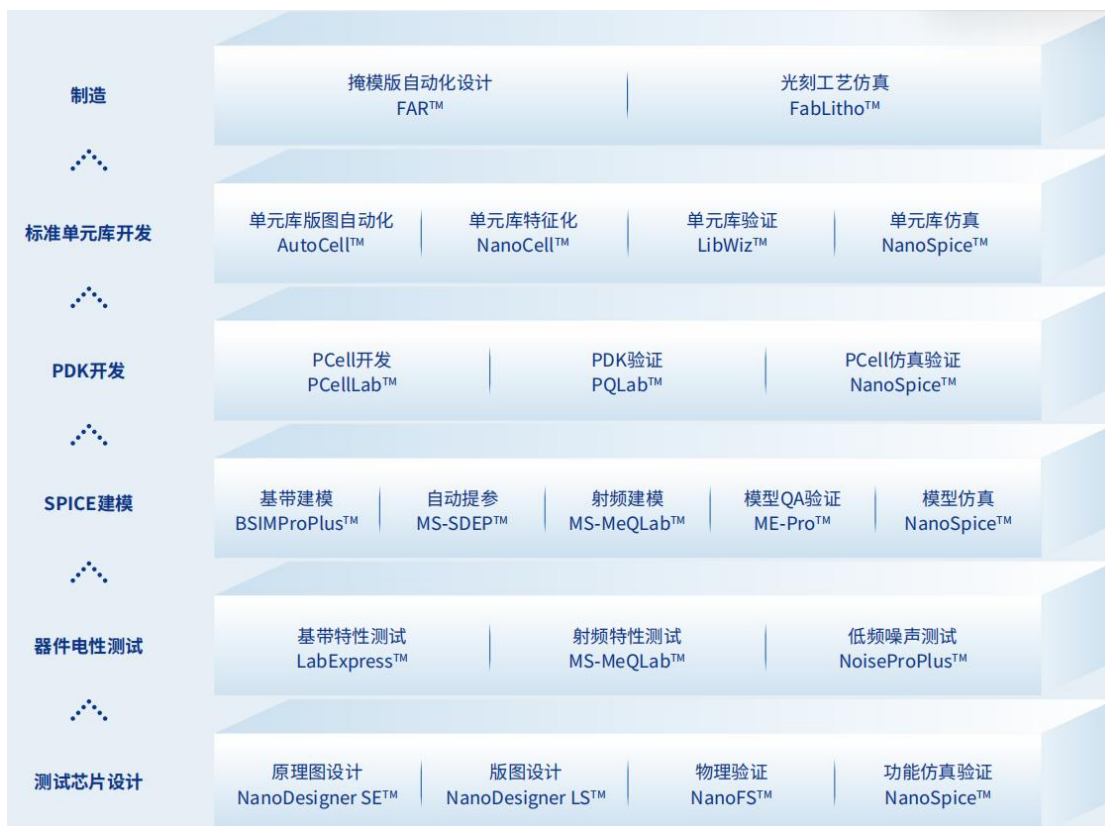
公司的主营业务为向客户提供被全球领先集成电路设计和制造企业长期广泛验证和使用的EDA全流程解决方案，主要产品及业务包括制造类EDA、设计类EDA、半导体器件特性测试系统和技术开发解决方案等。

#### (1) 制造类EDA

立足于行业领先的器件建模核心技术和先进方法学，公司制造类EDA产品线历经十余年不断迭代和创新，形成了业界领先的设计实现（Design Enablement）EDA综合解决方案，涵盖从测试芯片设计、器件电性测试、SPICE建模、PDK开发到标准单元库开发各阶段的十多款EDA产品，已被全球前十大晶圆代工厂和业界头部设计企业广泛应用于工艺平台研发、COT流程开发定制，和新材料、新器件、新工艺研发。

Design Enablement流程开发周期通常长达数月之久，是加快DTCO（设计制造协同优化）流程效率的瓶颈，公司通过将自动化、并行加速、云计算等先进方法学与EDA产品技术相结合，帮助客户显著提高生产效率，将开发周期从数月缩短至数周，助力芯片制造与设计更高效地协同优

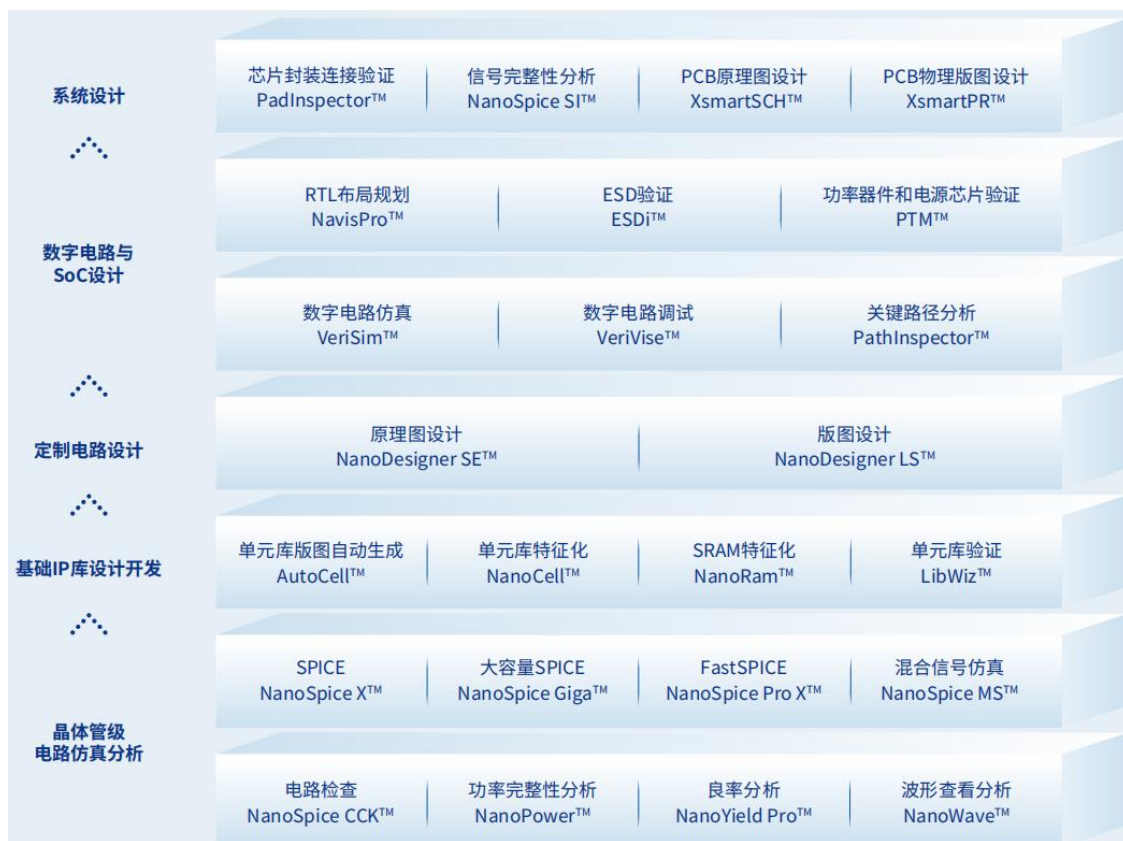
化，提升芯片产品 YPPA（指芯片 Yield 良率、Performance 性能、Power 功耗、Area 尺寸四大核心指标）。



## (2) 设计类 EDA

以 DTCO 理念构建应用驱动 EDA 全流程，公司设计类 EDA 基于行业领先的 SPICE 和 FastSPICE 电路仿真核心技术，产品线包括电路仿真分析、标准单元库优化、定制电路设计和数字电路与 SoC 设计。通过深入了解客户需求和市场趋势，不断提升现有产品的性能和功能，提高整体效率和可靠性，同时致力于新产品研发和发布，以填补市场空白、拓展产品线，满足不断涌现的新需求。

公司设计类产品全面覆盖存储器、人工智能、高性能计算和汽车电子等领域，广泛应用于设计公司全定制电路设计、SoC 芯片开发，IDM 与晶圆厂设计流程搭建，和科研院所芯片设计研发为客户提供领先的芯片设计 EDA 解决方案。



### (3) 半导体器件特性测试系统

公司电特性测试系统以卓越的性能和稳定的质量，与 EDA 产品软硬件协同，全面覆盖半导体器件电学特性测试、噪声特性测试、晶圆级电学参数测试和可靠性测试等领域，广泛应用于 IDM 与晶圆厂工艺平台研发，芯片设计公司 COT 流程开发和定制，和新材料、新器件及工艺研发，实现从科研到量产全覆盖。

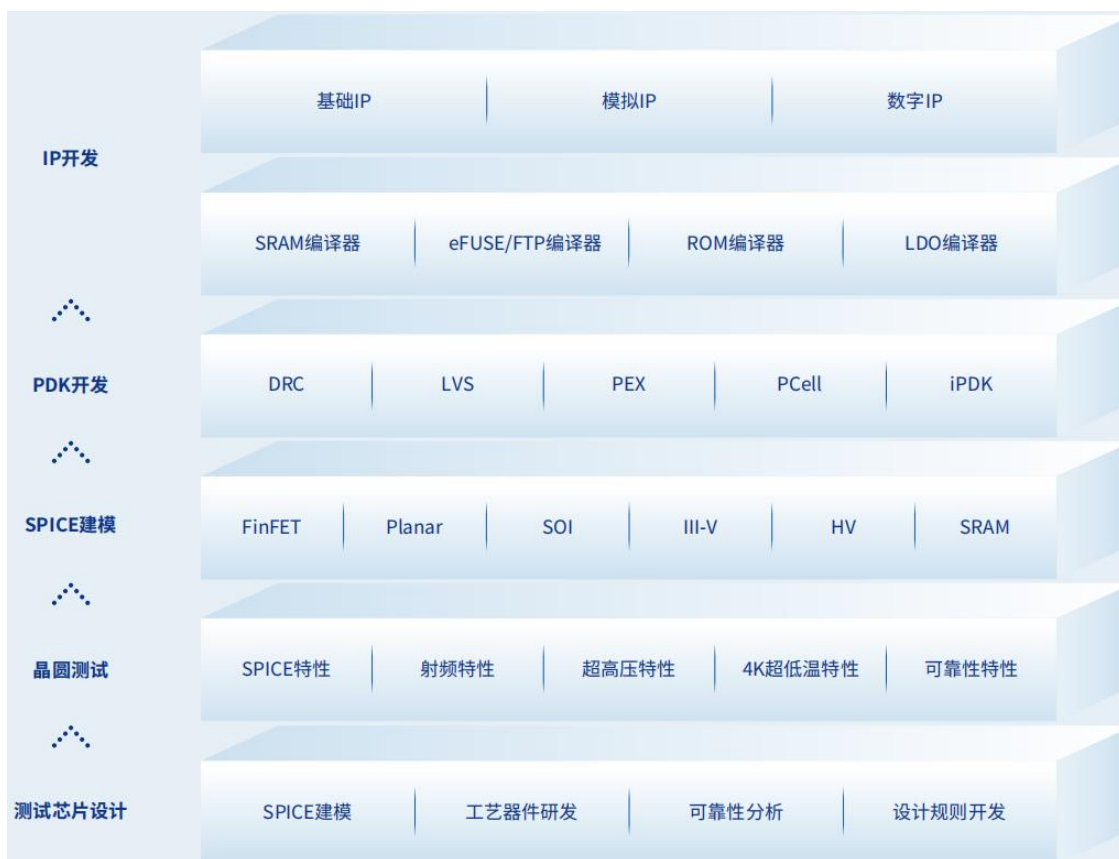
基于行业领先的核心技术，公司 98 系列低频噪声测试系统黄金工具已获得业界头部企业的普遍认可和应用，同时不断推进产品迭代和新品研发，为客户提供差异化和具有更高价值的数据驱动解决方案。



#### (4) 技术开发解决方案

公司以世界领先的晶圆测试实验室和超大规模的 EDA 计算中心为依托，结合自有 EDA 产品和先进的测试解决方案，凭借十余年服务全球领先设计和制造企业积累的丰富经验和技術能力，为客户提供专业的一站式技术开发解决方案，已广泛应用于 IDM/晶圆厂工艺平台研发，芯片设计公司 COT 流程开发和定制。

为应对日新月异的技术演进和行业发展，公司积极布局新材料及器件的创新应用解决方案，全面覆盖高压/超高压功率半导体、第三代化合物半导体、超导量子、超低温 MOS 等领域，为推动半导体工艺研发和芯片设计进程贡献自己的力量。



## 2.2 主要经营模式

公司的主要经营模式具体如下：

### 1. 盈利模式

公司主要盈利模式包括：

(1) 向客户授权 EDA 工具而获得软件授权相关收入。EDA 软件授权业务分为固定期限授权和永久期限授权，公司的 EDA 软件授权业务以固定期限授权业务为主，且多为三年期限授权。

公司对于固定期限授权的 EDA 工具，公司在授权期内持续对售出软件进行版本升级，并向客户提供技术咨询。对于固定期限授权业务，公司在授权期内按照直线法确认收入。

对于永久授权的 EDA 工具，公司向客户提供售出版本软件的永久使用权，并提供一定期间内的版本升级、技术咨询等后续服务，客户可在服务期满后单独购买后续服务。对于软件永久使用权销售以时点法确认收入，对于期间内的版本升级和技术咨询等服务在约定的服务期限内按照直线法确认收入。

(2) 向客户销售半导体器件特性测试系统而获得产品销售收入。

(3) 向客户提供技术开发解决方案而获得收入。

## 2. 采购模式

公司采购的主要内容为网络基础设施（如网络带宽、服务器等）和各类硬件模块及相关配件等。具体采购流程包括需求分析与技术评估、供应商选择与谈判、合同签订与执行、需求部门验收、供应商管理等。公司采购内容市场供应充足，供应商在具备可选性的同时保持相对稳定，能够满足公司的特定要求，采购渠道通畅。

## 3. 研发模式

公司研发团队根据市场和客户需求确定产品和技术研发方向，设定目标并开展研发工作，具体流程如下图：



## 4. 服务模式

### （1）技术支持服务

公司设有专门的技术服务团队，在服务期内为客户提供技术支持服务，有效满足客户使用需求，具体模式如下：

对于固定期限授权的 EDA 工具，公司在授权期内持续对售出软件进行版本升级，并向客户提供技术咨询；对于永久授权的 EDA 工具，公司向客户提供售出版本软件的永久使用权，并提供一定期限内的版本升级、技术咨询等后续服务，客户可在服务期满后单独购买后续服务。

对于半导体器件特性测试系统，公司提供一定期限内的软件版本升级、技术咨询等后续服务。客户可在服务期满后单独购买后续服务。

### （2）技术开发解决方案

公司的技术开发解决方案主要是利用自有的 EDA 工具和测试设备，基于自身为全球客户服务且多年积累的经验和能力，为客户提供测试结构设计、晶圆级测试、SPICE 建模、PDK 开发、标准单元库特性化及 IP 开发等一站式设计支持（Design Enablement）技术开发解决方案，并根据客户的应用提供相应的 EDA 工具、设计流程和增值的 EDA 解决方案。

目前，该项业务除了为客户提供基础的工程服务外，越来越多地附加了诸多新技术、新流程、新思维、新方法的开发，以及客户端 EDA 流程的建设和 EDA 产品的验证及导入，在交付基本的业务流程或业务结果外，为客户创造了额外的技术价值及技术成果。

## 5. 营销模式

公司目前采取以直销为主、经销为辅的销售模式，不断加强自身销售网络建设，积极通过展会、网络、行业媒体等渠道对公司及产品进行推广。对于北美、韩国、中国大陆等业务量较大的地区，公司主要采取直销模式，对于日本等地区主要采取经销模式。在面向大学及专业研究机构客户时，部分半导体器件特性测试系统的销售也会采取经销模式。

公司采取直销模式的地区多为客户资源多、市场需求大、业务基础较好的区域。该等区域内通常国际领先集成电路企业较为集中，为更好地服务客户，及时响应客户需求，公司通常配置本地化的销售和技术支持团队。基于投入产出比的考虑，公司在日本等地区，通过经销商的市场和销售渠道进行推广和销售。

## 6. 生产模式

公司硬件产品低频噪声测试仪器系列产品以及半导体参数测试仪器（FS-Pro、FS-MEMS）生产过程系通过对采购的标准化模块以及机箱组件进行简单装配并嵌入自主研发的软件产品并进行一系列功能检测、软硬件适配集成和调试校准。

公司硬件产品高精度源测量 SMU 和半导体参数测试系统 FS800 则采用协同式生产模式。通过直接采购标准化元器件等模块精准把控源头质量，借助其成熟工艺与规模优势确保品质与产能。相关机械部件则由公司自主设计，再交由供应商依据设计方案加工，实现设计与制造的高效衔接。所有加工完成的模块返回公司，凭借专业组装团队进行精细组装，在统一的质量管控体系下，将各部分整合为完整、高性能的 SMU 和 FS800 产品。

对于部分供货周期较长的供应商，公司通常根据销售预计情况提前安排采购，其余原材料在获取客户订单后开始安排采购，原材料齐备后通过简单装配并嵌入软件产品，并将其适配集成，调试至可使用状态。

## 7. 采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素和影响因素在报告期内的变化情况 及未来变化趋势

公司的主要收入来源于 EDA 软件授权，该等授权模式是国际 EDA 行业通行的经营模式。报告期内，公司经营模式及关键影响因素均未发生重大变化，在可预见的未来预计也不会发生重大变化。公司将围绕既定的战略布局，持续进行技术创新和积累，密切关注行业发展和变化，与客户和合作伙伴共同探讨行业新的技术趋势，不断对前沿技术进行探索和实践，并根据实际需要适当调整和优化现有经营模式。

## 2.3 所处行业情况

### (1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

EDA 行业作为集成电路产业的战略基础支柱与核心工业软件，贯穿芯片设计、制造、封测全流程，是支撑半导体产业创新发展的关键底座。2025 年，在国家产业政策持续支持、算力芯片等下游需求爆发、供应链自主可控要求提升、AI 技术深度渗透的多重驱动下，全球与中国 EDA 行业均进入格局重塑、技术迭代加速的关键时期，行业整体呈现高质量、结构化、生态化发展态势。

从发展阶段看，全球 EDA 行业已进入 AI 全面重构设计流程、巨头整合加固生态壁垒的成熟升级期，国际龙头通过并购、AI 研发与云化服务持续强化全流程、多物理场、系统级解决方案能力。中国 EDA 行业则迈入“规模化替代向高端突围转型、单点突破向全流程补齐升级”的深水区，成熟工艺与特色工艺领域替代成效显著，先进工艺与高端数字流程持续攻坚，行业由政策驱动逐步转向产品力、客户验证、生态协同三重驱动，正从“可用”向“好用”“管用”加速迈进，未来将在技术创新、市场渗透与产业生态构建上实现更大突破。

#### (1) EDA 行业的基本特点：

①AI 与 EDA 深度融合，智能化成为行业发展主线：人工智能、大模型与芯片设计流程深度融合，AI 辅助仿真、验证、布局布线、参数优化与良率提升等应用从试点探索走向规模化、工程化落地，显著提升设计效率、降低研发成本、缩短产品周期，推动 EDA 工具向自动化、智能化、平台化加速升级，成为行业技术迭代与竞争的核心方向。

②行业整合并购持续活跃，生态化竞争格局加速形成：全球 EDA 行业资源集中度不断提升，龙头企业通过并购整合实现技术补强、产品线延伸与多物理场能力拓展，强化全流程、系统级解决方案优势。国内企业亦围绕技术短板补齐、工具链完善、产业链协同开展并购与合作，推动行业从单点工具竞争转向平台化、生态化、全流程服务能力竞争。

③国产替代向纵深推进，呈现结构性高质量发展特征：国内 EDA 行业在政策支持、市场牵引与技术突破多重驱动下，由单点突破、局部可用加速迈向多点商用、规模替代。成熟工艺、模拟与特色工艺、器件建模、制造类 EDA 等领域替代成效显著；高端数字流程、先进工艺支持、全流程工具贯通等领域持续攻坚，行业整体向更高性能、更高可靠性、更全面流程升级。

#### (2) EDA 行业的技术门槛：

当前，EDA 技术已深度嵌入芯片研发全流程。从最初的系统级设计、硬件描述语言开发，到逻辑综合、功能验证、物理实现，再到版图验证和制造数据准备，EDA 工具承担着设计自动化、性能优化以及可制造性验证等关键任务。一颗先进的系统级芯片（SoC）在设计过程中往往需要

使用数十种乃至上百种 EDA 工具模块协同工作。EDA 不仅决定了芯片设计效率，更直接影响芯片性能、功耗与面积等关键指标，是支撑半导体产业发展的核心基础设施。

从技术角度来看，EDA 行业的技术门槛主要体现在以下几个方面：

①复杂算法体系的门槛：EDA 工具本质上是计算机科学、数学优化与电子工程深度融合的产物。在芯片设计过程中，需要解决大量复杂的优化问题，例如大规模逻辑综合、布局布线、时序收敛、功耗优化以及信号完整性分析等。其中许多问题需要通过启发式算法、图论方法以及机器学习等技术进行高效求解。例如在布局布线阶段，EDA 工具需要在有限芯片面积内对数百万甚至数亿个逻辑单元进行合理放置，并完成数亿级互连线路的规划，同时满足时序、功耗、布线密度以及制造规则等多重约束。算法性能的优劣将直接影响芯片 YPPA 指标。因此，高水平的算法体系构成了 EDA 技术最核心的壁垒之一。

②先进制造工艺适配的门槛：随着半导体工艺不断向 7nm、5nm 甚至更先进节点演进，芯片设计面临的制造复杂度显著提高。先进工艺节点中，设计规则数量呈指数级增长。EDA 工具必须在设计过程中实时完成设计规则检查（DRC），确保最终版图能够被晶圆厂成功制造。此外，先进节点普遍采用多重曝光技术以及 EUV 光刻工艺，对版图分割、掩模优化以及可制造性分析提出了更高要求。与此同时，器件结构如 FinFET、GAAFET 等也引入了更加复杂的物理效应，EDA 工具需要通过精确的器件模型、电路仿真和电磁仿真来保证设计结果的准确性。先进工艺的深度适配能力，成为 EDA 企业参与高端芯片设计市场的关键条件。

③完整设计流程平台的门槛：EDA 并非单一软件，而是覆盖芯片设计全生命周期的一整套工具体系。完整的 EDA 平台通常包括系统级设计、RTL 设计、逻辑综合、功能验证、形式验证、物理实现、时序分析、功耗分析、版图验证以及制造数据准备等多个环节。这些工具之间需要保持高度协同，不仅在数据格式上必须兼容，还需要在算法和流程上实现自动化衔接。只有形成完整的设计平台，才能真正支撑复杂芯片的设计需求。对于 EDA 企业而言，构建完整、稳定且高效的设计流程平台是构建长期竞争力的重要前提。

④超大规模计算能力的门槛：随着芯片规模持续扩大，EDA 工具需要处理的数据量也急剧增长。现代高端 SoC 芯片往往包含数十亿甚至上百亿个晶体管，设计数据库规模可达到 TB 级别。在这种规模下，EDA 软件需要具备强大的并行计算能力、分布式任务调度能力以及高效的数据管理架构。如何在保证计算效率的同时有效控制内存占用和数据传输成本，是 EDA 软件架构设计中的关键挑战。

⑤产业生态协同的门槛：EDA 工具并不是孤立存在的，而是深度嵌入整个半导体产业生态。EDA 企业需要与晶圆厂、芯片设计公司、IP 供应商以及封装测试企业建立紧密合作关系。其中，晶圆厂提供的 PDK 是芯片设计的关键基础数据包，包含器件模型、设计规则、工艺参数等重要信息。EDA 工具必须与 PDK 深度集成，才能保证设计结果能够在实际制造中成功实现。因此，EDA 企业不仅需要具备强大的技术能力，还需要建立稳定的产业合作网络。

此外，EDA 行业还具有研发周期长、投入强度高，客户粘性强、切换成本高的特点。一款成熟的 EDA 工具往往需要十年以上的技术积累和持续研发投入。国际领先 EDA 企业普遍拥有数千名研发工程师，并持续投入大量资源用于算法创新、软件工程优化以及工艺适配。这种长期技术积累构成了行业极高的进入壁垒。一旦芯片设计公司建立了完整的设计流程，其工程团队、设计数据库以及 IP 资源都会与特定 EDA 平台深度绑定，更换工具往往需要重新建立设计流程并承担较高的验证成本。因此，EDA 市场呈现出较高的行业集中度，领先企业往往能够在较长时间内保持稳定的市场地位。

总体而言，EDA 作为集成电路产业链的核心基础设施，其技术门槛主要体现在复杂算法体系、先进工艺适配能力、完整设计流程平台、超大规模计算能力以及产业生态协同等多个方面。正是这些技术门槛，使 EDA 成为全球半导体产业中技术壁垒最高、战略价值最突出的领域之一。

## (2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

由于 EDA 工具在集成电路行业中所起的关键作用，且 EDA 行业具有产品验证难、市场门槛高的特点，尤其对于国际知名客户，其对新企业、新产品的验证和认可门槛较高。因此，EDA 行业研发成果要转化为受到国际主流市场认可的产品，不仅需要持续大量的研发投入以形成在技术上达到先进水平的产品，还需要具备较强的品牌影响力、渠道能力、快速迭代能力等。衡量公司产品或服务市场地位、技术水平及特点的主要标准为国际市场和全球领先集成电路企业认可和量产采用情况。

公司较早地进行了 DTCO 方法学探索和实践，聚焦于 EDA 流程创新，择其关键环节进行逐个突破，先后成功拥有了具有国际市场竞争力的器件建模及验证 EDA 工具和电路仿真及验证 EDA 工具。公司器件建模及验证 EDA 工具已经取得较高市场地位，被全球大部分领先的晶圆厂所采用和验证，主要客户包括台积电、三星电子、联电、格芯、中芯国际等全球前十大晶圆厂；电路仿真和验证 EDA 工具已经进入全球领先集成电路企业，主要客户包括三星电子、SK 海力士、美光等，具备在关键细分领域国际领先的市场地位。

公司主要客户遍及全球领先的晶圆代工厂、存储器厂商和国内外知名集成电路设计企业。公司主要产品和服务在上述企业设计和制造的过程中使用，其设计或制造出的集成电路产品被广泛应用于数据处理、汽车电子、消费电子、物联网、工业、计算机及周边等产业中，实现科技成果与广泛下游终端应用的深度融合。公司对国内 EDA 的发展有独到的认识和超前的战略规划，拥有具备国际市场竞争力的领先核心技术，具备一个高科技硬核企业发展的所有关键要素，市场地位将持续显著提升。同时，公司客户类型多、覆盖范围广，客户结构更趋均衡，收入韧性显著增强，主流市场认可度与议价能力较强，不仅巩固了国产 EDA 领域的标杆地位，更成为支撑国内集成电路产业链自主可控的关键力量，行业话语权与产业协同能力得到全面强化。

### (3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

2025 年，EDA 行业在新技术、新产业、新业态和新模式等方面呈现出显著的发展趋势，为未来产业格局奠定了重要基础。

新技术层面，人工智能正成为推动 EDA 技术进步的核心驱动力。以生成式人工智能和基础模型为代表的新一代 AI 技术，正在逐步融入 EDA 工具链的关键环节，通过算法智能化与自动化能力的提升，在布局布线优化、功能验证、调试分析等环节实现效率跃升，大幅缩短芯片设计周期并降低设计复杂度。同时，DTCO 方法学持续深化，推动设计与制造环节更加紧密协同，在先进制程节点中发挥越来越关键的作用，有助于提升设计质量与制造良率。全球主要 EDA 厂商也在加速推出 AI 驱动的 EDA 平台和工具套件，通过算法与数据能力的融合，进一步强化技术差异化竞争优势。

新产业层面，人工智能、高性能计算、汽车电子等新兴应用领域的快速发展，对高性能、高可靠性芯片的需求持续增长，推动芯片架构和设计方法不断创新。与此同时，3DIC、Chiplet 等先进封装与系统集成技术逐渐成为重要发展方向，使得芯片设计向系统级协同设计转变。这一趋势对 EDA 工具提出了更高要求，推动其在多物理场协同仿真、系统级设计验证、先进封装设计等方向持续升级，从而成为支撑新一代半导体产业发展的关键基础工具。

新业态方面，“EDA+IP”的深度融合正在成为行业发展的重要趋势。EDA 和 IP 的协同是现代芯片设计和制造竞争力的关键，直接影响芯片设计的效率、质量和成功率，EDA 和 IP 两者相互依存、协同发展，共同推动半导体产业的创新与进步。EDA 行业处于需要创新驱动的集成电路产业最上游，是实现技术创新的源头，其自身的创新尤为重要。EDA 和 IP 的发展均需契合集成电路行业的技术发展趋势，根据市场需求变动和工艺水平发展及时对现有技术进行升级换代，需要持续满足行业动态发展的需求，且时刻面对国际竞争对手产品快速升级迭代的技术竞争，以持

续保持产品竞争力。新思科技和铿腾电子均早在九十年代末期就通过并购进入 IP 市场，目前已成为仅次于 ARM 的全球第二和第三大 IP 供应商，新思科技、铿腾电子等国际巨头的外延式发展和 EDA+IP 协同的路径已成为行业发展的典范，也证明了 EDA+IP 商业模式的可行性。

新模式方面，各主要国家和地区也在通过政策支持和产业引导，推动本土 EDA 产业能力建设，加强技术创新与供应链安全保障。在这一背景下，EDA 行业正在逐步形成以“技术研发、生态整合和产业应用协同发展”为特征的新模式。通过构建开放协同的产业生态，推动技术、工具与应用场景的深度融合，将为 EDA 行业的长期发展持续注入新的动力。

### 3、公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年 增减(%)	2023年
总资产	2,568,264,966.17	2,465,703,479.40	4.16	2,518,818,229.77
归属于上市公司股东的净资产	2,004,024,768.14	1,951,619,806.64	2.69	2,094,705,214.65
营业收入	483,670,553.41	419,080,178.55	15.41	328,896,154.28
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	476,338,730.67	417,131,879.18	14.19	327,711,855.84
利润总额	41,203,080.13	-99,737,229.22	不适用	-55,757,177.23
归属于上市公司股东的净利润	34,243,200.13	-95,970,755.94	不适用	-56,315,589.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-59,567,586.71	-89,486,714.30	不适用	-66,655,612.27
经营活动产生的现金流量净额	137,764,379.04	-46,515,613.62	不适用	51,030,263.22
加权平均净资产收益率(%)	1.74	-4.78	增加6.52个百分点	-2.65
基本每股收益(元/股)	0.08	-0.22	不适用	-0.13
稀释每股收益(元/股)	0.08	-0.22	不适用	-0.13
研发投入占营业收入的比例(%)	67.48	68.90	减少1.42个百分点	72.05

## 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	91,423,973.13	127,020,706.78	96,166,728.26	169,059,145.24
归属于上市公司股东的净利润	1,504,070.84	44,674,571.95	-4,187,899.74	-7,747,542.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-13,828,072.69	8,844,987.57	-14,532,248.60	-40,052,252.99
经营活动产生的现金流量净额	9,694,526.65	9,667,650.19	-11,187,247.20	129,589,449.40

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

## 4、 股东情况

## 4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)							15,024
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							15,522
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）							0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数（户）							0
前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记 或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
KLProTech H.K. Limited	-17,006,297	74,630,812	17.15	0	无	0	境外法人
刘志宏	0	70,055,723	16.10	0	无	0	境外自然人
共青城明伦投资合伙企业（有限合伙）	-1,542,319	29,304,047	6.73	0	无	0	其他
共青城峰伦投资合伙企业（有限合伙）	-1,210,565	23,000,723	5.29	0	无	0	其他

上海临港科创投资管理有限公司—上海芯合创一号私募投资基金合伙企业（有限合伙）	21,758,893	21,758,893	5.00	0	无	0	其他
共青城伟伦投资合伙企业（有限合伙）	-1,083,352	20,583,692	4.73	0	无	0	其他
共青城金秋股权投资管理合伙企业（有限合伙）	-6,989,331	18,416,482	4.23	0	无	0	其他
共青城经伦投资合伙企业（有限合伙）	-509,455	9,679,648	2.22	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司—南方信息创新混合型证券投资基金	5,068,545	6,417,235	1.47	0	无	0	其他
共青城嘉橙股权投资合伙企业（有限合伙）	-2,346,412	5,549,382	1.28	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	金秋投资、嘉橙投资均为由公司董事陈晓飞实际控制的主体。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

#### 存托凭证持有人情况

适用 不适用

#### 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

适用 不适用

### 5、公司债券情况

适用 不适用

### 第三节 重要事项

1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

详见公司 2025 年年度报告第三节“管理层讨论与分析”之“二、经营情况讨论与分析”的相关表述。

2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用